

2024-2030年中国IC制造行业市场竞争态势及发展前景研判报告

报告大纲

一、报告简介

智研咨询发布的《2024-2030年中国IC制造行业市场竞争态势及发展前景研判报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.chyxx.com/research/1188875.html>

报告价格：电子版: 9800元 纸介版：9800元 电子和纸介版: 10000元

订购电话: 010-60343812、010-60343813、400-600-8596、400-700-9383

电子邮箱: sales@chyxx.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

智研咨询发布的《2024-2030年中国IC制造行业市场竞争态势及发展前景研判报告》共十五章。首先介绍了IC制造行业市场发展环境、IC制造整体运行态势等，接着分析了IC制造行业市场运行的现状，然后介绍了IC制造市场竞争格局。随后，报告对IC制造做了重点企业经营状况分析，最后分析了IC制造行业发展趋势与投资预测。您若想对IC制造产业有个系统的了解或者想投资IC制造行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 IC行业介绍

1.1 IC相关组成部分

1.1.1 存储器

1.1.2 逻辑电路

1.1.3 微处理器

1.1.4 模拟电路

1.2 IC制造工艺

1.2.1 热处理工艺

1.2.2 光刻工艺

1.2.3 刻蚀工艺

1.2.4 离子注入工艺

1.2.5 薄膜沉积工艺

1.2.6 清洗

1.3 IC行业产业链结构

1.3.1 上游设计环节

1.3.2 中游制造环节

1.3.3 下游封测环节

1.4 IC相关制造模式

1.4.1 IDM模式

1.4.2 Foundry模式

1.4.3 Chipless模式

第二章 2019-2023年全球IC制造行业运行情况

2.1 全球IC制造业发展概况

2.1.1 IC制造市场运行现状

2.1.2 全球IC制造竞争格局

2.1.3 全球IC制造工艺发展

2.1.4 全球IC制造企业发展

2.1.5 IC制造企业发展态势

2.2 全球IC制造业技术专利

2.2.1 全球申请趋势分析

2.2.2 优先权的国家分析

2.2.3 主要的申请人分析

2.2.4 技全球术态势分析

2.3 全球集成电路产业园区

2.3.1 美国

2.3.2 日本

2.3.3 欧洲

2.3.4 亚太

第三章 2019-2023年中国IC制造发展环境分析

3.1 经济环境

3.1.1 全球宏观经济

3.1.2 国内宏观经济

3.1.3 工业和建筑业

3.1.4 宏观经济展望

3.2 社会环境

3.2.1 人口结构分析

3.2.2 居民收入水平

3.2.3 居民消费水平

3.2.4 工业企业利润

3.3 投资环境

3.3.1 固定资产投资

3.3.2 社会融资规模

3.3.3 财政收支安排

3.3.4 地方投资计划

第四章 2019-2023年中国IC制造政策环境分析

4.1 国家政策解读

4.1.1 促进集成电路产业高质量发展发政策

4.1.2 促进集成电路产业高质量发展所得税

4.1.3 促进制造业产品和服务质量提升意见

4.1.4 工业和通信业职业技能提升行动计划

4.1.5 制造业设计能力提升专项行动计划

4.2 IC行业相关标准分析

4.2.1 IC标准组织

4.2.2 IC国家标准

4.2.3 行业IC标准

4.2.4 团体IC标准

4.2.5 IC标准现状

4.3 “十四五”IC产业政策

4.3.1 注重工艺制造人才的引进

4.3.2 半导体投资不宜盲目跟风

4.3.3 加大关键设备国产化支持

第五章 2019-2023年中国IC制造行业运行情况

5.1 中国IC制造业整体发展概况

5.1.1 IC制造业产业背景

5.1.2 IC制造业发展规律

5.1.3 IC制造业相关特点

5.1.4 IC制造业发展逻辑

5.2 中国IC制造业发展现状分析

5.2.1 IC制造业发展现状

5.2.2 IC制造业销售规模

5.2.3 IC制造业市场占比

5.2.4 IC制造业未来增量

5.2.5 IC制造业水平对比

5.3 中国台湾IC制造行业运行分析

5.3.1 中国台湾IC制造发展历程

5.3.2 中国台湾IC产业全球份额

5.3.3 中国台湾IC产值具体分布

- 5.3.4 中国台湾重点IC公司营收
- 5.3.5 中国台湾IC产值未来预测
- 5.4 2019-2023年中国IC进出口数据分析
 - 5.4.1 进出口总量数据分析
 - 5.4.2 主要贸易国进出口情况分析
 - 5.4.3 主要省市进出口情况分析
- 5.5 IC制造业面临的问题与挑战
 - 5.5.1 IC制造业面临问题
 - 5.5.2 IC制造业生态问题
 - 5.5.3 IC制造业发展挑战
- 5.6 IC制造业发展的对策与建议
 - 5.6.1 IC制造业发展策略
 - 5.6.2 IC制造业生态对策
 - 5.6.3 IC制造业政策建议

第六章 IC制造产业链介绍

- 6.1.1 IC制造产业链整体介绍
- 6.1.2 上游——原料和设备
- 6.1.3 中游——制造和封装
- 6.1.4 下游——应用市场
- 6.2 设计市场发展现状分析
 - 6.2.1 IC设计企业整体运行
 - 6.2.2 IC设计市场规模分析
 - 6.2.3 IC设计公司数量变化
 - 6.2.4 IC设计市场存在问题
 - 6.2.5 IC设计行业机遇分析
- 6.3 封装市场发展现状分析
 - 6.3.1 封装市场简单概述
 - 6.3.2 半导体的封装市场
 - 6.3.3 先进封装市场运行
 - 6.3.4 封装市场发展方向
- 6.4 测试市场发展现状分析
 - 6.4.1 IC测试内容
 - 6.4.2 IC测试规模
 - 6.4.3 IC测试厂商

6.4.4 IC测试趋势

第七章 2019-2023年IC制造相关材料市场分析

7.1 IC材料市场整体运行分析

7.1.1 IC材料市场发展现状

7.1.2 IC材料市场发展思路

7.1.3 IC材料产业现存问题

7.1.4 IC材料市场发展目标

7.1.5 IC材料产业发展展望

7.2 硅片材料

7.2.1 硅片制造工艺

7.2.2 硅片制造方法

7.2.3 市场运行情况

7.2.4 硅片产业机遇

7.2.5 硅片产业挑战

7.3 光刻材料

7.3.1 光刻材料的组成

7.3.2 光刻胶整体市场

7.3.3 光刻胶市场竞争

7.3.4 光刻胶产业特点

7.3.5 光刻胶产业问题

7.3.6 光刻胶提升方面

7.3.7 光刻胶发展建议

7.4 抛光材料

7.4.1 主要的材料介绍

7.4.2 光刻胶发展历程

7.4.3 光刻胶发展现状

7.4.4 产品相关的企业

7.5 其他材料市场分析

7.5.1 掩模版

7.5.2 湿化学品

7.5.3 电子气体

7.5.4 靶材及蒸发材料

7.6 材料市场重大工程建设

7.6.1 IC关键材料及装备自主可控工程

7.6.2 相关材料、工艺及装备验证平台

7.6.3 先进半导体材料在终端领域应用

7.7 材料市场发展对策建议

7.7.1 抓住战略发展机遇期

7.7.2 布局下一代的IC技术

7.7.3 构建产业技术创新链

第八章 2019-2023年IC制造环节设备市场分析

8.1 半导体设备

8.1.1 半导体设备市场规模

8.1.2 半导体设备国产化率

8.1.3 半导体设备政策支持

8.1.4 半导体设备市场格局

8.1.5 半导体设备主要产商

8.1.6 半导体设备投资占比

8.1.7 半导体设备规模预测

8.2 晶圆制造设备

8.2.1 晶圆制造设备主要类型

8.2.2 晶圆制造设备市场规模

8.2.3 制造设备市场份额分析

8.2.4 晶圆制造设备投资占比

8.2.5 晶圆制造设备规模预测

8.3 光刻机设备

8.3.1 光刻机发展历程

8.3.2 光刻机的产业链

8.3.3 光刻机市场供应

8.3.4 光刻机设备占比

8.3.5 全球光刻机销量

8.4 刻蚀机设备

8.4.1 刻蚀机的主要分类

8.4.2 刻蚀机的市场规模

8.4.3 刻蚀机市场集中度

8.4.4 刻蚀机的国产替代

8.4.5 刻蚀机的规模预测

8.5 硅片制造设备

- 8.5.1 制造设备简介
- 8.5.2 市场厂商分布
- 8.5.3 主要设备涉及
- 8.5.4 设备市场规模
- 8.5.5 设备市场项目
- 8.6 检测设备
 - 8.6.1 检测设备主要分类
 - 8.6.2 检测设备市场占比
 - 8.6.3 检测设备市场格局
 - 8.6.4 工艺检测设备分析
 - 8.6.5 晶圆检测设备分析
 - 8.6.6 FT测试设备分析
- 8.7 中国IC设备企业
 - 8.7.1 屹唐半导体科技有限公司
 - 8.7.2 中国电子科技集团有限公司
 - 8.7.3 盛美半导体设备股份有限公司
 - 8.7.4 北方华创科技集团股份有限公司

第九章 2019-2023年晶圆制造厂具体市场分析

- 9.1 晶圆制造厂市场运行分析
 - 9.1.1 全球晶圆制造产能
 - 9.1.2 全球晶圆制造产量
 - 9.1.3 中国晶圆厂的建设
 - 9.1.4 晶圆厂的市场招标
 - 9.1.5 晶圆制造产能预测
- 9.2 晶圆代工厂市场运行分析
 - 9.2.1 全球晶圆代工市场
 - 9.2.2 全球晶圆代工工厂
 - 9.2.3 中国晶圆代工市场
 - 9.2.4 中国晶圆代工工厂
- 9.3 中国晶圆厂生产线分布
 - 9.3.1 12英寸（300mm）晶圆生产线
 - 9.3.2 8英寸（200mm）晶圆生产线
 - 9.3.3 6英寸及以下尺寸晶圆生产线
 - 9.3.4 化合物半导体晶圆生产线

9.4 晶圆厂建设市场机遇

9.4.1 供给端来看

9.4.2 需求端来看

第十章 2019-2023年IC制造相关技术分析

10.1 IC制造技术指标

10.1.1 集成度

10.1.2 特征尺寸

10.1.3 晶片直径

10.1.4 封装

10.2 化学机械抛光CMP

10.2.1 化学机械研磨CMP

10.2.2 CMP国产化现状

10.2.3 CMP国产化协作

10.3 光刻技术

10.3.1 光刻技术耗时

10.3.2 光刻技术内涵

10.3.3 光刻技术工艺

10.4 刻蚀技术

10.4.1 刻蚀技术简介

10.4.2 主流刻蚀技术

10.4.3 刻蚀技术壁垒

10.5 IC技术发展趋势

10.5.1 尺寸逐渐变小

10.5.2 新技术和材料

10.5.3 新领域的运用

第十一章 2019-2023年IC制造行业建设项目分析

11.1 研发及产业化建设项目

11.1.1 项目概况

11.1.2 项目必要性分析

11.1.3 项目可行性分析

11.1.4 项目投资概算

11.2 芯片测试产能建设项目

11.2.1 项目概况

- 11.2.2 项目必要性分析
- 11.2.3 项目可行性分析
- 11.2.4 项目投资概算
- 11.3 存储先进封测与模组制造项目
 - 11.3.1 项目基本情况
 - 11.3.2 项目必要性分析
 - 11.3.3 项目可行性分析
 - 11.3.4 项目投资概算
- 11.4 晶圆制程保护膜产业化建设项目
 - 11.4.1 项目必要性分析
 - 11.4.2 项目投资概算
 - 11.4.3 项目周期进度
 - 11.4.4 审批备案情况
- 11.5 8英寸MEMS国际代工线建设项目
 - 11.5.1 项目基本情况
 - 11.5.2 项目必要性分析
 - 11.5.3 项目可行性分析
 - 11.5.4 项目投资概算
 - 11.5.5 项目经济效益

第十二章 国外IC制造重点企业介绍

- 12.1 英特尔股份有限公司
 - 12.1.1 企业发展概况
 - 12.1.2 企业经营状况分析
- 12.2 三星电子
 - 12.2.1 企业发展概况
 - 12.2.2 企业经营状况分析
- 12.3 德州仪器
 - 12.3.1 企业发展概况
 - 12.3.2 企业经营状况分析
- 12.4 海力士半导体公司
 - 12.4.1 企业发展概况
 - 12.4.2 企业经营状况分析
- 12.5 安森美半导体
 - 12.5.1 企业发展概况

12.5.2 企业经营状况分析

第十三章 国内IC制造重点企业介绍

13.1 中国台湾积体电路制造公司

13.1.1 企业发展概况

13.1.2 经营效益分析

13.1.3 业务经营分析

13.1.4 财务状况分析

13.1.5 核心竞争力分析

13.1.6 公司发展战略

13.2 华润微电子有限公司

13.2.1 企业发展概况

13.2.2 经营效益分析

13.2.3 业务经营分析

13.2.4 财务状况分析

13.2.5 核心竞争力分析

13.2.6 公司发展战略

13.3 芯源微电子设备股份有限公司

13.3.1 企业发展概况

13.3.2 经营效益分析

13.3.3 业务经营分析

13.3.4 财务状况分析

13.3.5 核心竞争力分析

13.3.6 公司发展战略

13.4 中芯国际集成电路制造有限公司

13.4.1 企业发展概况

13.4.2 经营效益分析

13.4.3 业务经营分析

13.4.4 财务状况分析

13.4.5 核心竞争力分析

13.4.6 公司发展战略

13.5 闻泰科技股份有限公司

13.5.1 企业发展概况

13.5.2 经营效益分析

13.5.3 业务经营分析

13.5.4 财务状况分析

13.5.5 核心竞争力分析

13.5.6 公司发展战略

第十四章 2019-2023年IC制造业的投资市场分析

14.1 IC产业投资分析

14.1.1 IC产业投资基金

14.1.2 IC产业投资机会

14.1.3 IC产业投资问题

14.1.4 IC产业投资思考

14.2 IC投资基金介绍

14.2.1 IC投资资金来源

14.2.2 IC投资具体项目

14.2.3 IC投资金额情况

14.2.4 IC投资基金营收

14.3 IC制造投资分析

14.3.1 投资的整体市场

14.3.2 IC制造投资市场

14.3.3 IC制造投资项目

第十五章 2024-2030年IC制造行业趋势分析

15.1 IC制造业发展的目标与机遇

15.1.1 IC制造业发展目标

15.1.2 IC制造业发展趋势

15.1.3 IC制造业崛起机遇

15.1.4 IC制造业发展机遇

15.2 2024-2030年中国IC制造业预测分析

15.2.1 2024-2030年中国IC制造业影响因素分析

15.2.2 2024-2030年中国IC制造业规模预测

图表目录

图表 晶圆制造流程

图表 氧化工艺的用途

图表 光刻工艺流程图

图表 光刻工艺流程简介

图表 湿法刻蚀和干法刻蚀对比

图表 具有多晶硅栅和铝金属化CMOS芯片刻蚀工艺

图表 离子注入与扩散工艺比较

图表 离子注入机细分市场格局

图表 CVD与PVD工艺比较

图表 化学薄膜沉积工艺过程

图表 三种CVD工艺对比

图表 半导体清洗的污染物种类、来源及危害

图表 IDM模式流程图

图表 IC制造领域全球专利按专利权人指标图

更多图表见正文.....

详细请访问：<https://www.chyxx.com/research/1188875.html>